

苏州市科技计划项目验收证书

苏科验字〔2020〕733号

计划类别：重点产业技术创新->重点研发产业化

项目编号：SGC201709

项目名称：球栅阵列结构 PCB 的特种激光切割及成孔技术的研发及产业化

承担单位：苏州光韵达光电科技有限公司

主管部门：高新区科技创新局

项目合作单位：

项目负责人：王荣

项目组成员：惠国庆、潘浩、戴闻起、郭学亮、王华杰、陈龙、沈祺舜、李军军

验收形式：会议验收

验收结论：验收通过

发证日期：

项目验收委员会名单：

姓名	单位	性别	专业	职务或职称
倪俊芳	苏州大学机电工程学院	男	机电工程	教授
蒋建强	苏州经贸职业技术学院	男	机械工程、数控技术	教授
张小伟	苏州科技大学	男	无机非金属材料	副教授
蔡建	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	男	无机非金属材料	总经理/教授级高工/国贴专家
繆俊浩	苏州苏诚会计师事务所	男	财务审计	注册会计师

项目验收意见：

2020年1月14日，受苏州市科技局委托，苏州高新区（虎丘区）科技创新局组织专家对苏州光韵达光电科技有限公司承担的苏州市重点产业技术创新项目“球栅阵列结构 PCB 的特种激光切割及成孔技术的研发及产业化”（项目编号：SGC201709）进行验收。专家组听取了项目承担单位的汇报，审查了相关项目验收材料，经讨论形成以下验收意见：

一、项目承担单位提供的验收资料齐全，规范，符合验收要求。

二、该项目取得的成果如下：

（1）项目通过研究激光钻孔孔型不正和钻孔位置的解决方法、钻孔边缘残留物的清除的问题，获取了一种精密度高、速度快、切割面整齐并且最小化的碳化程度的激光切割工艺，全面达到了合同要求的技术指标；

（2）项目申请了发明专利 6 件；

（3）项目实现销售收入 3815.33 万元，新增利税 776.16 万元；

（4）新增就业岗位 16 个；达到预期指标。

三、该项目获得市级经费 30 万元，经费管理使用合理。

验收专家组认为该项目完成了合同规定的各项指标和任务。一致同意通过验收。